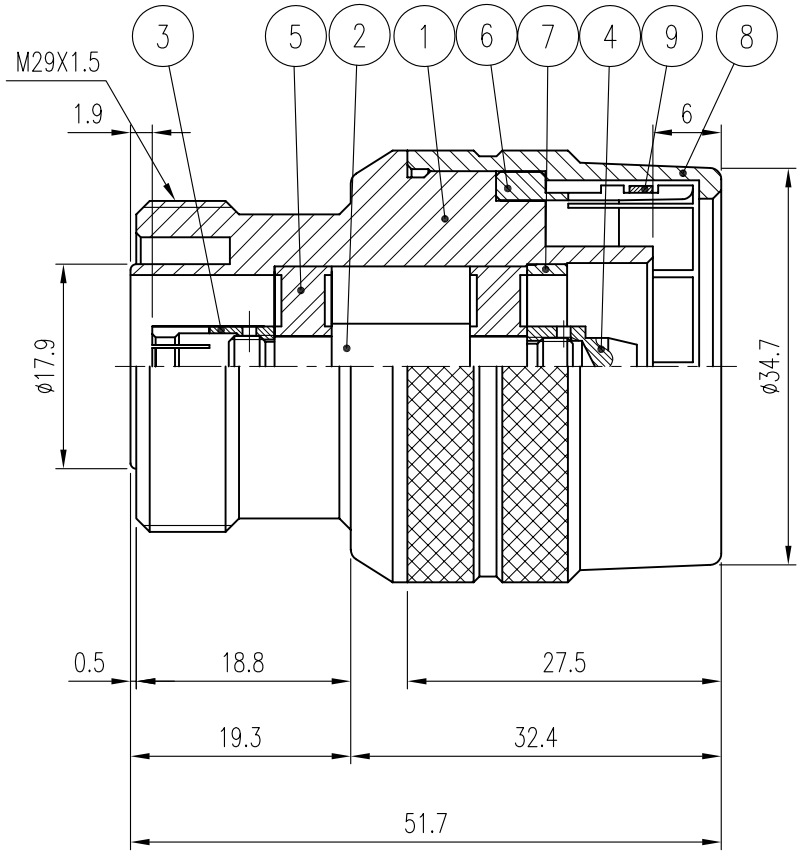
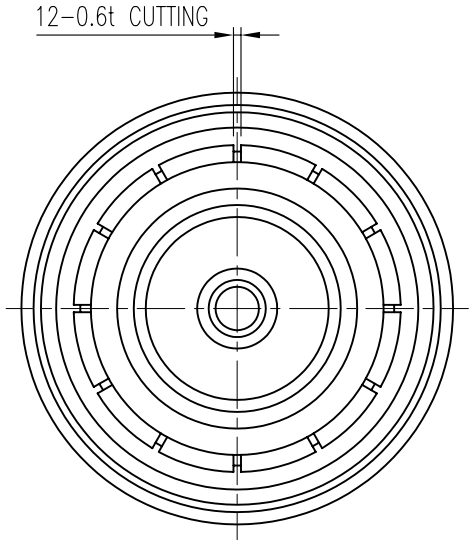
| ST \ 가공 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| ST(기존) | | | | | | | | | | |
| ST(개선) | | | | | | | | | | |

| 수 정 내 용 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 부호 | 내 용 | 수정자 | 승인자 | 년 월 일 |
| | | | | |
| | | | | |




## * 조 립 주 기

1. 양쪽 핀 나사체결 후 납땜 할 것.

## * SPEC

1. Impedance: 50Ω NOMINAL
2. Frequency Range : DC ~ 6GHz
3. Insertion Loss : -0.15dB (max)
4. V.S.W.R : 1.1 : 1 (max)
5. 삽입반복시험 : 500회 이상

| 품번 | 품 명 | 수량 | 재 질 | 표면처리 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SPRING RING | 1 | BeCu | SUCO Plate | DSR00022-5/1 (R5005) |
| 8 | CAP | 1 | MBsBD | SUCO Plate | DCU00077-5/1 (K5017) |
| 7 | INSERT BODY | 1 | MBsBD | SUCO Plate | DSR00067-5/1 (M5009) |
| 6 | JACK | 1 | MBsBD | SUCO Plate | DJA00062-5/1 (J5013) |
| 5 | INSULATOR | 2 | TEFLON | | DIN00942-N/1 (H5086) |
| 4 | CONTACT | 1 | MBsBD | Silver Plate(5μ) | DCT00871-5/1 (E5117) |
| 3 | CONTACT | 1 | BeCu | Silver Plate(5μ) | DCT00859-5/1 (E5116) |
| 2 | CONTACT | 1 | MBsBD | Silver Plate(5μ) | DCT00840-5/1 (E5115) |
| 1 | BODY | 1 | MBsBD | SUCO Plate | DBD01046-5/1 (D5106) |

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2004. 6. 10.

승인

검도

제도

직성부서 연 구 소

척도 1.5/1 단위 mm 중량


KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017


도명
DIN(M)-DIN(F) PUSH ON

A4

도번 AD00134-7/1

K318-703-000